



通信行业：芯片巨头携卫星通信技术亮相 MWC 关注卫星通信投资机会



核心观点:

周观点：手机芯片巨头携卫星通信技术亮相 MWC 大会，卫星通信迈入实质性加速阶段。2023 世界移动通信大会（MWC23）在西班牙巴塞罗那会展中心举行，三大手机芯片厂商高通、联发科、紫光展锐分别展示了在 5GNTN（Non-Terrestrial Network，非地面网络）等卫星通信技术的布局，为手机直连卫星打下了良好基础。

高通：公司宣布正在和 Motorola、Nothing、OPPO、vivo、荣耀、小米等手机厂商合作，支持手机厂商基于高通年初发布的 Snapdragon Satellite 解决方案，开发具备卫星通信功能的智能手机。联发科：联发科则率先推出了全球首款支持双向卫星通信安卓手机，其和 Bullitt 合作推出的支持卫星服务的智能手机摩托罗拉 defy2 和 CATS75 均采用联发科 MT68253GPPNTN 芯片组。同时，联发科还在展会上分享了下一代 5GNTN 技术，以迎接未来支持卫星通信的新型设备。紫光展锐：紫光展锐在年初联合产业合作伙伴，率先完成了全球首次 S 频段 5GNTN 技术上星验证，确认了公司开发的终端可用于手机直连卫星场景和天地一体物联网场景。大会上，紫光展锐对 NTN 相关技术和验证成果进行了展示。目前，公司 NTN 芯片、GNSS 定位芯片均已完成研制

我国卫星互联网高速发展，产业链进展频传。2021 年 4 月，中国卫星网络集团有限公司（简称“星网”）成立，其控股股东及实控人为国资委(持股比例 100%)。国家顶层统筹国内低轨卫星互联网建设计划.....2022

年7月12日,上海市人民政府办公厅发布《上海市数字经济发展“十四五”规划》,提出将建设空天一体的卫星互联网,瞄准中低轨路线,完善卫星制造、卫星发射、卫星运营及服务产业链,探索天地一体化商业运营新模式。

卫星组网,制造先行,重视制造环节细分领域机会。卫星互联网产业链主要包括卫星制造、火箭发射、地面设备及卫星运营四大环节,各环节将根据组网节奏自上而下受益。从产业链上我们持续看好上市公司在制造环节的细分领域机会。我们认为,卫星互联网的产业链成熟度持续提升,已经迈入实质性加速阶段,预计未来产业相关催化会更加密集。建议关注卫星互联网 T/R 芯片及组件环节的铖昌科技、国博电子(军工和电子联合覆盖),卫星载荷环节的信科移动以及姿态传感+星间通信用窄线宽激光器及其模块厂商光迅科技。

风险提示。5G 应用渗透不及预期的风险; IDC 新建设项目落地不及预期的风险; 5G 技术运用带来的产品技术迭代的风险; 上游芯片技术发展带来产品技术迭代风险。

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_53166

